

BGA返修台

产品名称	BGA返修台
公司名称	深圳市金邦达科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区固戍崩山工业区4栋4楼
联系电话	86-075527696998 15012665289

产品详情

BGA返修台 GM-5360 产品特点

人性化的系统控制

真彩工业触摸屏+智能工业控制模块，控制可靠

Windows界面，人性化UI接口设计，方便操作

中英文人机界面

BGA焊接拆解过程自动化

软件指示BGA焊接流程，操作步骤清晰。

精准的温度控制

三温区独立控温，智能PID算法，BGA焊接温度控制精度达 ± 1

软件控制风扇无极调速，无需外接气源

海量BGA温度曲线存储

BGA温度曲线快速设置和索引查找

支持自动温度曲线分析

大流量横流扇自动对PCB板进行冷却，防止PCB板变形

精密的机械部件

V型卡槽、异性PCB支架

X、Y方向运动采用精密导轨

完善的安全设计

BGA返修台具有风扇失效保护、热电偶失效保护功能

超温失效保护、超温快速切断功能

软件数值输入校验和限制功能

上加热头具有防撞防压保护功能

基本功能

界面设置“焊接”、“拆解”、“参数设置”等多级菜单，方便人员操作

BGA焊接采用三温区独立控温，第一、二温区可设置8段升(降)温+恒温控制。

第三温区大面积IR加热器对PCB板全面预热，以保证膨胀系数均匀板不变形

外置4路测温接口实现同时对不同检测点温度的精密检测

PCB板定位采用V字形槽，定位快捷、方便、准确，满足不同PCB板的定位

在拆卸、焊接完毕后采用大流量横流扇自动对PCB板进行冷却，防止PCB板变形，保证焊接效果。

BGA 焊接对象

本BGA返修台适用于任何BGA器件及高难返修元器件做BGA焊接，包括CCGA、BGA、QFN、CSP、LGA、Micro SMD、MLF

适用于有铅和无铅工艺

BGA返修台 GM-5360 技术参数

类别	项目	规格参数
温度控制系统	加热温区数量	3个独立温区，分为上温区、下温区、预热
	加热温区功率	上部加热功率：800W 下部加热功率：800W 红外区热功率：2700W
	加热方式	热风加热，不需要外部气源，风速软件无级
	温度控制算法	K型热电偶+智能PID温度闭环精确控制

	温度控制精度	± 1
	温度曲线数量	海量
	温度曲线分析	支持温度曲线分析功能
	外置测温端口数量	4个（可扩展）
PCB及BGA尺寸	PCB尺寸	Max 420X400mm ， Min 10X10mm
	BGA尺寸	2X2—80X80mm
	PCB装夹方式	V型卡槽、PCB支架，并外配万能夹具
	BGA吸取方式	内置真空泵，BGA芯片手动吸取
控制系统	控制方式	真彩工业触摸屏+工业控制模块
	控制界面	多功能人性化的操作界面，Windows XP操
	过程控制	焊接、拆卸过程实现智能化控制
其它参数	机械外形尺寸	600x600x780mm
	重量	50Kg
	电源	4300W

BGA返修台 GM-5360 随机附件

	随机附件		
	上热风嘴		
	下热风嘴		

异性PCB支架		
K型热电偶线		
真空吸盘		
操作说明书		